

# 精密プレス刃型・卓上基板分割機 PACシリーズ

カットアウト(ミシン目)基板の接合部を精密なプレス刃型で分断！  
小個片の多数取り集合基板も一括分断できるので、量産工程用設備として対応可能！



PAC-HP (手動式)



PAC-S4000TP2 (エアー式)

## 特徴

基板の材質・厚み・形状を問わず、あらゆる分割作業に対応できます。  
クイックダイチェンジ機構により、型交換はスピーディーに行えます(3分以内)。  
精密な刃の噛み合わせにより、基板にダメージを与えず高精度な打ち抜きが可能です。  
チップ・オン・ボード (COB)、チップ・オン・フレキ (COF) いずれにも対応できます。

## 仕様

項目	機種	PAC-HP	PAC-S4000TP2
加圧方式		手動式	エアーシリンダ駆動式
加圧能力		1,500kg	4,000kg
対応基板寸法		150 × 250mm	200 × 250mm
対応基板材質		ガラエポ (FR-4・CEM3他) / 紙フェノール / アルミ / セラミック	
搭載部品高さ制限		部品面: MAX・20mm / ハンダ面: MAX・10mm	
外形寸法 / 重量		435 × 502 × 522.5mm / 85kg	730 × 900 × 800mm / 270kg

## 上下プレス刃型

精密に吻合する上下刃で、接合部を正確に打ち抜きます。



## 基材別刃型

リジッド基板	上下合わせ刃型		
フレキ基板	当て切り刃型		

## 異形基板の分割

1シートあたりの接続部が多い異形集合基板用分割機として高い適性を有します。

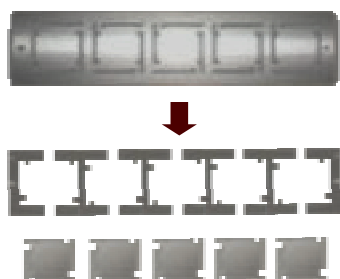
個片が異形基板

## 異形基板用プレス刃型

接続部が多い異形集合基板用の分割型では刃数が多くなります。

## アルミ基板の分割

精密に吻合する上下刃がバリの無いクリアな切断面を形成します。



## セラミック基板の分割作業

ルーター式装置を含め他の方式では、分割が難しいセラミック基板にも専用の刃型を製作する事で対応可能。精密に噛み合う上下刃により、割れ易いセラミック基板を高精度に切り分ける事が可能です。

